

京信教育ローン「教育LINE」の電子契約サービスを導入します ～お申込からご契約まで、WEBでお手続きが完結します～

京都信用金庫（本店：京都市下京区 理事長：榊田 隆之、以下「当金庫」）は京信教育ローン「教育LINE」の電子契約サービスを新たに導入しますので、お知らせします。

本サービスは、セイコーソリューションズ株式会社（代表取締役社長：関根 淳）の電子契約サービス「融資クラウドプラットフォーム」を使用します。従来はご契約に必要な書類をお客様から郵送いただいていたおりましたが、今後はお申込からご契約までWEB上でスピーディーにお手続きが完結します。

また、WEB上の電子署名にて契約を行うため、必要事項の記入漏れや印鑑不備等の心配がなく、さらにペーパーレスのため印紙代のご負担はありません。お客様はご自身のスマホ、タブレット、PCの画面上で契約内容をご確認いただき、保存いただくことが可能になります。

当金庫は今後もデジタルサービスを拡充し、お客様の利便性向上に取り組んでまいります。

記

1. 取扱開始日

2020年8月3日（月）

2. 対象商品

京信教育ローン「教育LINE」

商品の概要は下記の申込サイトからご確認ください。

<http://www2.kyoto-shinkin.co.jp/kyoiku/>

3. サービスの利用方法

申込時にご申告いただいたメールアドレスに、電子契約サイトのURLを送信します。同サイトにアクセスいただき、審査結果の確認およびご契約手続きを行っていただきます。

以上